

证券代码：600460

公司简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250827

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	士兰微 2025 年半年度业绩说明会
时间	2025 年 8 月 27 日 14:00-15:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长：陈向东 副董事长、总经理：郑少波 独立董事：宋春跃 董事会秘书、财务负责人：陈越
投资者关系 活动主要内 容介绍	投资者关系活动主要内容 问题 1：基于最新市场情况，请介绍一下公司产品下游各应用领域，如消费、工业、汽车等下半年的市场供需状况？ 回答：下半年特别是第四季度是汽车市场的旺季，也是白电市场的旺季，士兰会处在产销紧平衡的状态。其他消费、工业预估维持上半年的状态。 问题 2：车规级市场是不是已有见顶趋势？公司如何研判下半年宏观市场情况？ 回答：对士兰微电子来说，大部分产品的车规市场刚开始。 （1）IGBT 主驱（成品模块 + 芯片）我们已有较大的份额；接下来在 SiC 模块上将有较大成长空间，目前士兰微电子属于领跑者； （2）IGBT 单管：在车载 OBC、压缩机、热管理领域，士兰是领跑者，还有很大的成长空间； （3）中低压 SGT-MOSFET，在油泵、刹车、助力转向等领域，有

	大量产品在应用，也是国内车用 MOSFET 出货量最大的一家； （4）车用的模拟电路：隔离驱动、预驱、低边驱动、高边驱动、E-FUSE 都已有客户在量产与评测。成长可期。 问题 3：请问公司各产线下半年的产能利用率情况如何，以及各大产品类别价格走势及市场需求状况如何？ 回答：5 吋、6 吋、8 吋、12 吋硅线完全满载，6 吋 SiC 尚有产能放空，LED 基本满载。成都封装产线也基本满产。 问题 4：公司如何看待人工智能产业未来发展前景？公司将如何捕捉机遇？今年都有哪些新的布局？ 回答：人工智能的发展不可限量。公司在各类功率器件（高压硅 MOSFET、SiC-MOSFET、低压 SGT-MOSFET、硅基 GaN-HEMT 器件等）、高性能模拟电路（DrMOS、多相电源控制器、E-Fuse 等）上都有针对性的布局与产品。 问题 5：您好，咨询下 6 吋碳化硅目前月产量实际有多少，是否供不应求，看中报目前建设至 1 万片/月，应该达到了规划产能吧？后续 8 吋碳化硅大概今年四季度何时能通线，到时候是否与车商有更大的合作？ 回答：目前 6 吋 SiC 实际的月产量小于 5000 片，暂时没有供不应求。产能已接近设计产能。8 吋大线年底能通线，跑出可评价的产品。目前 II 代和 IV 代 SiC 芯片都在推广，进展顺利。IV 代 SiC 芯片目前是非常先进的。 问题 6：请问士兰微 MEMS 主要的手机厂家有哪些？ 回答：国内几家主要的品牌手机都有在使用和评测我们的 MEMS 惯性传感器。之前是纯三轴的加速度计。去年下半年开始量产六轴惯性传感器（三轴加速度计+三轴陀螺）。
--	---